

平成25年2月7日

各位

会社名 富士通株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 正巳
(コード番号 6702 東証第一部)
問合せ先 広報IR室長 山守 勇
(TEL. 03-6252-2175)

会社名 パナソニック株式会社
代表者名 取締役社長 津賀 一宏
(コード番号 6752 東証・大証・名証第一部)
問合せ先 財務・IRグループ
グループマネジャー 水野 省三
(TEL. 06-6908-1121)

システムLSI事業の統合新会社設立に関する基本合意について

富士通株式会社（本社：東京都港区、以下、富士通）とパナソニック株式会社（本社：大阪府門真市、以下、パナソニック）は、本日、富士通の100%子会社である富士通セミコンダクター株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 晴基、以下、富士通セミコンダクター）およびパナソニックのそれぞれが営むシステムLSI事業の設計・開発機能などを統合し、外部投資家の出資を得て、システムLSIの設計・開発などを手掛けるファブレス形態の新会社（以下、統合新会社）を設立するとともに、新会社へ事業移管することを検討することで基本合意いたしました。統合新会社の設立にあたっては、株式会社日本政策投資銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本徹、以下、日本政策投資銀行）へ出融資等をお願いしております。なお、富士通とパナソニックは今後具体的な検討を進め、すみやかに最終的な契約の締結を目指してまいります。

記

1. 統合新会社設立の背景および目的

富士通セミコンダクターおよびパナソニックは、システムLSIに関する先端技術や多くの知的財産を有しており、先進的なシステムLSIの提供を通じて国内外のお客様の製品を支えてきました。しかし、近年、市況の急激な悪化や海外半導体メーカーの台頭により、両社のシステムLSI事業は厳しい状況に直面しています。こうした中、富士通とパナソニックは、両社のシステムLSI事業が今後も市場で成長していくためには、マーケティング・設計・開発機能に特化（ファブレス化）すると共に、両社の先端技術や顧客基盤を集約してグローバルに競争力のある事業体制を構築する必要があるとの認識で一致し、統合新会社の設立を検討することで合意しました。

統合新会社は、①ハイパフォーマンス・ソリューション（高性能サーバ、超高速ネットワークなどクラウドインフラを支えるコアテクノロジー）、②ビジュアル&イメージング・ソリューション（次世代DTV、画像認識の応用分野など）、③ワイヤレス・ソリューション（ユビキタスネットワークを支えるモバイル・微弱無線等のコネクティビティ・ソリューション）などにおいて、グローバルトップレベルのシステムLSIカンパニーとなることを目指し、両社がこれまでに培った技術力を結集すると共に注力分野への新規投資を重点的に進めます。注力分野におけるグローバルな競争力を高めるための投資資金の調達については、日本政策投資銀行と具体的な協議を行ってまいります。

2. 基本合意の内容

両社の基本合意事項は以下の通りです。

- (1) 富士通とパナソニックは、富士通セミコンダクターおよびパナソニックにおけるシステムLSI事業を統合し、外部投資家の出資を得て、システムLSIの設計・開発などを手掛けるファブレス形態の新会社を設立すると共に、新会社へ事業移管することを検討する。
- (2) 統合新会社は、富士通セミコンダクターおよびパナソニックが保有する技術やノウハウ、顧客基盤などをベースに、両社が強みとしてきた製品分野に経営資源を集中し、独立した事業体として、グローバル市場におけるリーディングカンパニーを目指す。

3. 今後のスケジュール

富士通とパナソニックは今後具体的な検討を進め、すみやかに最終的な契約の締結を目指します。

以上